

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

PCT/JP 00/00951
09/914363

22 03.00

REC'D 19 MAY 2000

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年 7月27日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第212068号

出 願 人

Applicant (s):

日東電工株式会社

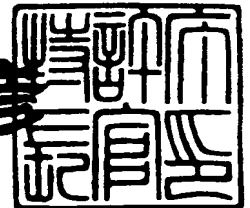
PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 4月28日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近 藤 隆 彦



出証番号 出証特2000-3030433

特平 1 1 - 2 1 2 0 6 8

【書類名】 特許願
【整理番号】 N11-49
【提出日】 平成11年 7月27日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C08G 59/00
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社
内
【氏名】 原田 忠昭

【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社
内
【氏名】 細川 敏嗣
【特許出願人】
【識別番号】 000003964
【氏名又は名称】 日東電工株式会社
【代理人】
【識別番号】 100079382
【弁理士】
【氏名又は名称】 西藤 征彦
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 平成11年特許願第 48905号
【出願日】 平成11年 2月25日
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 026767
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 要約書 1

特平 11-212068

【包括委任状番号】 9103012

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体封止用樹脂組成物およびそれを用いた半導体装置ならびに半導体装置の製法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 下記の (A) ~ (D) 成分を含有する半導体封止用樹脂組成物であって、上記半導体封止用樹脂組成物の粘度が 25℃で 7000 poise 以上で、かつ 80℃で 5000 poise 以下に設定されていることを特徴とする半導体封止用樹脂組成物。

(A) 液状エポキシ樹脂。

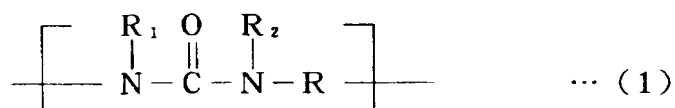
(C) 潜在性硬化促進剤。

(D) 無機質充填剤。

【請求項 2】 上記 (B) 成分である固形フェノール樹脂が、多官能固形フェノール樹脂である請求項 1 記載の半導体封止用樹脂組成物。

【請求項 3】 上記 (C) 成分である潜在性硬化促進剤が、硬化促進剤からなるコア部が、下記の一般式 (1) で表される構造単位を有する重合体を主成分とするシェル部で被覆されたコア/シェル構造を有するマイクロカプセル型硬化促進剤である請求項 1 または 2 記載の半導体封止用樹脂組成物。

【化 1】



〔上記式 (1) において、R は 2 価または 3 価の有機基、R₁、R₂ はいずれも水素原子または 1 価の有機基であって、相互に同じであっても異なってもよい。〕

【請求項 4】 上記 (D) 成分である無機質充填剤が、球状溶融シリカ粉末であって、上記球状溶融シリカ粉末が、半導体封止用樹脂組成物全体中に 15 ~ 85 重量%の割合で含有されている請求項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載の半導体

封止用樹脂組成物。

【請求項 5】 配線回路基板上に、複数の接続用電極部を介して半導体素子が搭載され、上記配線回路基板と半導体素子との間の空隙が封止樹脂層によって封止されてなる半導体装置であって、上記封止樹脂層が、請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載の半導体封止用樹脂組成物によって形成されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 6】 配線回路基板上に、複数の接続用電極部を介して半導体素子が搭載され、上記配線回路基板と半導体素子との間の空隙が封止樹脂層によって封止されてなる半導体装置の製法であって、上記配線回路基板と半導体素子との間の空隙に、請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載の半導体封止用樹脂組成物を充填した後、硬化させることにより上記封止樹脂層を形成することを特徴とする半導体装置の製法。

【請求項 7】 配線回路基板面上に半導体素子が搭載され、配線回路基板と半導体素子とが電氣的に接続され、上記半導体素子を内蔵するように半導体素子の周囲を封止樹脂層によって封止してなる半導体装置であって、上記封止樹脂層が、請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載の半導体封止用樹脂組成物によって形成されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 8】 配線回路基板面上に半導体素子が搭載され、配線回路基板と半導体素子とが電氣的に接続され、上記半導体素子を内蔵するように半導体素子の周囲を封止樹脂層によって封止してなる半導体装置の製法であって、上記半導体素子搭載面側の配線回路基板上に請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載の半導体封止用樹脂組成物を供給した後、硬化させることにより上記封止樹脂層を形成することを特徴とする半導体装置の製法。

【請求項 9】 実装用基板上に、複数の接続用電極部を介して樹脂封止層が形成された半導体装置が、それ自体の配線回路基板を対面させた状態で搭載され、上記実装用基板と半導体装置との間の空隙が封止樹脂層によって封止されてなる半導体製品であって、上記封止樹脂層が、請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載の半導体封止用樹脂組成物によって形成されていることを特徴とする半導体製品。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、エポキシ樹脂系の封止剤であり、80℃以下の比較的低温下で低粘度を示し、特に吐出、塗布作業性に優れ、しかも貯蔵安定性に優れた半導体封止用樹脂組成物およびそれを用いた半導体装置ならびに半導体装置の製法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

イング)、COB (Chip On Board, チップオンボード) 等における半導体封止には、液状封止剤が用いられている。そして、上記液状封止剤は、室温(25℃)で使用され、ディスペンサー、印刷等によって半導体素子を樹脂封止することにより、半導体装置が製造される。このような液状封止剤としては、一般に、液状のエポキシ樹脂と、酸無水物系硬化剤と、通常の硬化促進剤と、シリカ粉末とを含有してなるエポキシ樹脂組成物が知られている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記液状封止剤は、硬化剤として酸無水物系硬化剤を用いるため、封止剤の液状化は容易であり、吐出および塗布作業性は良好であるが、耐湿下での吸湿率が高くなり、耐湿信頼性に劣るという問題が生じる。また、上記液状封止剤は、室温で液状であるため貯蔵安定性が悪く、室温貯蔵時に粘度が大きく上昇したり、シリカ粉末が沈降したりするため、樹脂を凍らせて固形化する等の、特別の貯蔵手段を講じる必要がある。

【0004】

本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、耐湿信頼性および貯蔵安定性に優れるとともに、吐出および塗布作業性にも優れた半導体封止用樹脂組成物およびそれを用いた半導体装置、ならびにその半導体装置の製法を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するため、本発明は、下記の（A）～（D）成分を含有する半導体封止用樹脂組成物であって、上記半導体封止用樹脂組成物の粘度が25℃で7000 poise以上で、かつ80℃で5000 poise以下に設定されている半導体封止用樹脂組成物を第1の要旨とする。

- （A）液状エポキシ樹脂。
- （B）固形フェノール樹脂。
- （C）潜在性硬化促進剤。
- （D）無機質充填剤。

【0006】

また、本発明は、配線回路基板上に、複数の接続用電極部を介して半導体素子が搭載され、上記配線回路基板と半導体素子との間の空隙が封止樹脂層によって封止されてなる半導体装置であって、上記封止樹脂層が、上記半導体封止用樹脂組成物によって形成されている半導体装置を第2の要旨とする。

【0007】

さらに、本発明は、配線回路基板上に、複数の接続用電極部を介して半導体素子が搭載され、上記配線回路基板と半導体素子との間の空隙が封止樹脂層によって封止されてなる半導体装置の製法であって、上記配線回路基板と半導体素子との間の空隙に、上記半導体封止用樹脂組成物を充填した後、硬化させることにより上記封止樹脂層を形成する半導体装置の製法を第3の要旨とする。

【0008】

また、配線回路基板面上に半導体素子が搭載され、配線回路基板と半導体素子とが電氣的に接続され、上記半導体素子を内蔵するように半導体素子の周囲を封止樹脂層によって封止してなる半導体装置であって、上記封止樹脂層が、上記半導体封止用樹脂組成物によって形成されている半導体装置を第4の要旨とする。

【0009】

さらに、配線回路基板面上に半導体素子が搭載され、配線回路基板と半導体素子とが電氣的に接続され、上記半導体素子を内蔵するように半導体素子の周囲を

封止樹脂層によって封止してなる半導体装置の製法であって、上記半導体素子搭載面側の配線回路基板上に上記半導体封止用樹脂組成物を供給した後、硬化させることにより上記封止樹脂層を形成する半導体装置の製法を第5の要旨とする。

【0010】

そして、実装用基板上に、複数の接続用電極部を介して樹脂封止層が形成された半導体装置が、それ自体の配線回路基板を対面させた状態で搭載され、上記実装用基板と半導体装置との間の空隙が封止樹脂層によって封止されてなる半導体製品であって、上記封止樹脂層が、上記半導体封止用樹脂組成物によって形成されている半導体製品を第6の要旨とする。

すなわち、本発明者は、耐湿信頼性および貯蔵安定性に優れるとともに、吐出および塗布作業性にも優れた封止材料を得るため一連の研究を重ねた。その結果、液状エポキシ樹脂と固形フェノール樹脂と潜在性硬化促進剤と無機質充填剤とを用い、しかも25℃および80℃の各温度において特定の粘度を有する樹脂組成物を用いると、所期の目的を達成できることを見出し本発明に到達した。

【0012】

特に、上記固形フェノール樹脂として、多官能固形フェノール樹脂を用いた場合には、ガラス転移温度(T_g)が高くなり、耐熱性が向上するという利点がある。

【0013】

そして、上記潜在性硬化促進剤として、特定のシェル部で硬化促進剤からなるコア部が被覆されたコア／シェル構造を有するマイクロカプセル型硬化促進剤を用いた場合、それを含有してなる半導体封止用樹脂組成物は、可使時間が非常に長くなり、貯蔵安定性に特に優れるという利点がある。

【0014】

さらに、無機質充填剤として球状溶融シリカ粉末を用い、これが半導体封止用樹脂組成物全体中に特定の割合で含有されている場合には、流動性に優れるようになり、吐出および塗布作業性に特に優れるという利点がある。

【0015】

【発明の実施の形態】

つぎに、本発明の実施の形態について詳しく説明する。

【0016】

本発明の半導体封止用樹脂組成物は、液状エポキシ樹脂（A成分）と、固形フェノール樹脂（B成分）と、潜在性硬化促進剤（C成分）と、無機質充填剤（D成分）とを用いて得られるものであり、25℃および80℃の各温度でそれぞれ特定の粘度を有するものである。

【0017】

上記液状エポキシ樹脂（A成分）としては、25℃で液状を示すものであれば特に限定するものではなく各種のエポキシ樹脂を用いることができる。例えば、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、アリル化ビスフェノール型エポキシ樹脂等があげられる。これらは単独であるいは2種以上併せて用いられる。なお、本発明において上記液状エポキシ樹脂とは、単独で用いた場合25℃で液状を示すことはもちろん、2種以上併用した場合において最終的にエポキシ樹脂成分として25℃で液状を示すものをも含む趣旨である。

【0018】

そして、A成分である液状エポキシ樹脂としては、エポキシ当量が110～220g/epのものを用いることが好ましく、なかでもエポキシ当量が140～200g/epのものを用いることが好適である。

【0019】

上記A成分とともに用いられる固形フェノール樹脂（B成分）としては、上記液状エポキシ樹脂（A成分）の硬化剤として作用するものであって、25℃で固形を示すものであれば特に限定するものではなく各種のフェノール樹脂を用いることができるが、初期の目的を損なわない範囲であれば、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、無水フタル酸等の酸無水物系硬化剤やアミン類を併用してもよい。上記固形フェノール樹脂としては、例えば、多官能固形フェノール樹脂、ビスフェノール樹脂、ナフタレン型フェノール樹脂、フェノールノボラック樹脂、トリフェニルメタン型フェ

ノール樹脂等があげられる。これらは単独であるいは2種以上併せて用いられる。ここで、多官能固形フェノール樹脂とは、フェノール性水酸基が2個以上ついた芳香族環を少なくとも1個有し、かつ1分子中のフェノール性水酸基の総数が3個以上であり、しかも芳香族環を少なくとも1分子中に2個以上有する固形フェノール樹脂をいう。このような多官能固形フェノール樹脂としては、例えば、三官能固形フェノール樹脂、四官能固形フェノール樹脂、五官能固形フェノール樹脂等があげられる。なお、多官能固形フェノール樹脂を用いる場合は、数平均分子量が450以下のものを用いることが好適である。なお、本発明において上記固形フェノール樹脂とは、単独で用いた場合25℃で固形を示すことはもちろ

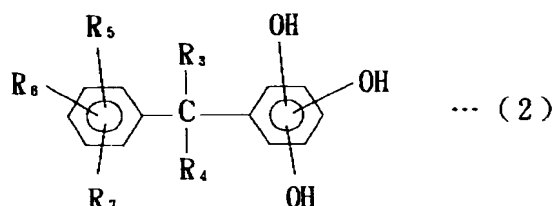
固形を示すものをも含む趣旨である。

【0020】

上記固形フェノール樹脂（B成分）のうち三官能固形フェノール樹脂としては、例えば下記の一般式（2）で表される構造のフェノール樹脂、下記の一般式（3）で表される構造のフェノール樹脂等があげられる。

【0021】

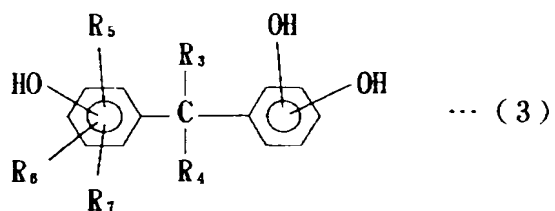
【化2】



〔上記式（2）において、R₃～R₇は水素原子またはメチル基であって、互いに同じであっても異なってもよい。〕

【0022】

【化 3】



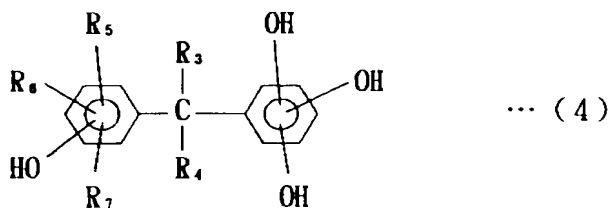
〔上記式 (3) において、 $R_3 \sim R_7$ は水素原子またはメチル基であつて、互いに同じであっても異なっているもよい。〕

【0 0 2 3】

また、上記固形フェノール樹脂 (B 成分) のうち四官能固形フェノール樹脂としては、例えば下記的一般式 (4) で表される構造のフェノール樹脂、下記的一般式 (5) で表される構造のフェノール樹脂等があげられる。

【0 0 2 4】

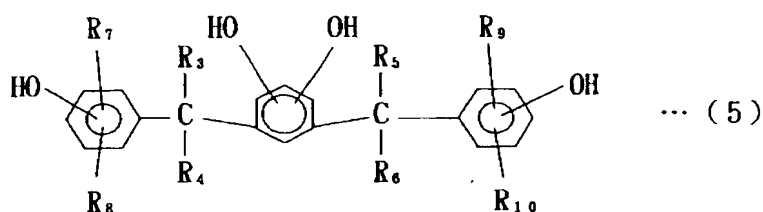
【化 4】



〔上記式 (4) において、 $R_3 \sim R_7$ は水素原子またはメチル基であつて、互いに同じであっても異なっているもよい。〕

【0 0 2 5】

【化5】

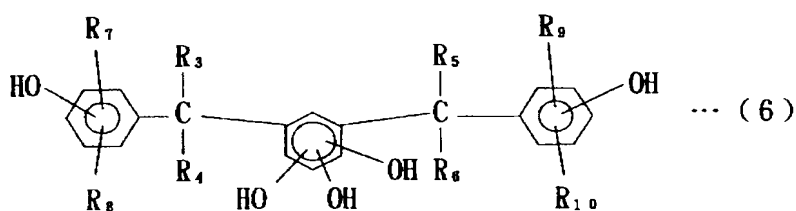


〔上記式(5)において、 $R_3 \sim R_{10}$ は水素原子またはメチル基であつて、互いに同じであっても異なっているもよい。〕

また、上記固形フェノール樹脂(B成分)のうち五官能固形フェノール樹脂としては、例えば下記的一般式(6)で表される構造のフェノール樹脂等があげられる。

【0027】

【化6】



〔上記式(6)において、 $R_3 \sim R_{10}$ は水素原子またはメチル基であつて、互いに同じであっても異なっているもよい。〕

【0028】

そして、B成分である固形フェノール樹脂としては、水酸基当量が30～260 g/epで、軟化点が40～100℃または融点が50～210℃のものを用いることが好ましく、なかでも水酸基当量が50～110 g/epで、軟化点が60～90℃または融点が70～190℃のものを用いることが好適である。

【0029】

上記液状エポキシ樹脂（A成分）と固形フェノール樹脂（B成分）との配合割合は、上記エポキシ樹脂中のエポキシ基1当量当たりフェノール樹脂中の水酸基が0.6～1.4当量となるように配合することが好適である。より好適には、0.7～1.1当量である。

【0030】

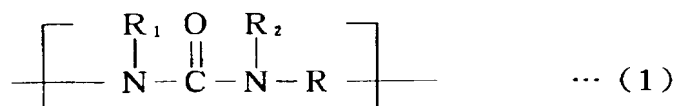
上記液状エポキシ樹脂（A成分）と固形フェノール樹脂（B成分）との組み合わせにおいては、例えば、ビスフェノールF型エポキシ樹脂と多官能固形フェノール樹脂とを組み合わせる用いることが、流動性、耐熱性、硬化性の点から好ましい。

【0031】

上記A成分およびB成分とともに用いられる潜在性硬化促進剤（C成分）は、これを含含有してなる半導体封止用樹脂組成物の50℃雰囲気下72時間放置後における粘度（測定温度：80℃）が、放置前における粘度の10倍以下になるものであり、例えば、各種の硬化促進剤からなるコア部が、下記の一般式（1）で表される構造単位を有する重合体を主成分とするシェル部で被覆されたコア／シェル構造を有し、そのシェル部に存在する反応性アミノ基がブロック化されているマイクロカプセル型硬化促進剤があげられる。このようなマイクロカプセル型硬化促進剤を用いることにより、これを含含有してなる半導体封止用樹脂組成物は、可使時間が非常に長くなり、貯蔵安定性に特に優れるようになる。なお、通常の硬化促進剤を少量にした場合であっても、放置前の粘度に対し10倍以下、通常、1～3倍となるのであれば潜在性硬化促進剤として考える。

【0032】

【化 7】



〔上記式(1)において、Rは2価または3価の有機基、R₁、R₂はいずれも水素原子または1価の有機基であって、相互に同じであっても異なってもよい。〕

【0033】

進剤としては、硬化反応を促進する作用を有するものであれば特に限定するものではなく、従来公知のものが用いられる。そして、この場合、マイクロカプセルを調整する際の作業性や得られるマイクロカプセルの特性の点から、室温で液状を示すものが好ましい。なお、室温で液状とは、硬化促進剤自身の性状が室温(25℃)で液状を示す場合のほか、室温で固体であっても任意の有機溶剤等に溶解もしくは分散させて液状にしたものをも含むものである。

【0034】

そして、上記内包される硬化促進剤としては、例えば、アミン系、イミダゾール系、リン系、ホウ素系、リン-ホウ素系等の硬化促進剤があげられる。具体的には、エチルグアニジン、トリメチルグアニジン、フェニルグアニジン、ジフェニルグアニジン等のアルキル置換グアニジン類、3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素、3-フェニル-1,1-ジメチル尿素、3-(4-クロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素等の3-置換フェニル-1,1-ジメチル尿素類、2-メチルイミダゾリン、2-フェニルイミダゾリン、2-ウンデシルイミダゾリン、2-ヘプタデシルイミダゾリン等のイミダゾリン類、2-アミノピリジン等のモノアミノピリジン類、N,N-ジメチル-N-(2-ヒドロキシ-3-アリロキシプロピル)アミン-N'-ラクトイミド等のアミンイミド系類、エチルホスフィン、プロピルホスフィン、ブチルホスフィン、フェニルホスフィン、トリメチルホスフィン、トリエチルホスフィン、トリブチルホスフ

イン、トリオクチルホスフィン、トリフェニルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、トリフェニルホスフィン／トリフェニルボラン錯体、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート等の有機リン系化合物、1, 8-ジアザビシクロ〔5, 4, 0〕ウンデセン-7、1, 4-ジアザビシクロ〔2, 2, 2〕オクタン等のジアザビシクロアルケン系化合物等があげられる。これらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。なかでも、硬化促進剤含有マイクロカプセルの作製の容易さ、また取扱い性の容易さという点から、上記イミダゾール系化合物や有機リン系化合物が好適に用いられる。

【0035】

前記式(1)で表される構造単位を有する重合体を主成分とする重合体は、例えば、多価イソシアネート類と多価アミン類との重付加反応によって得られる。あるいは、多価イソシアネート類と水との反応によって得られる。

【0036】

上記多価イソシアネート類としては、分子内に2個以上のイソシアネート基を有する化合物であればよく、具体的には、m-フェニレンジイソシアネート、p-フェニレンジイソシアネート、2, 4-トリレンジイソシアネート、2, 6-トリレンジイソシアネート、ナフタレン-1, 4-ジイソシアネート、ジフェニルメタン-4, 4'-ジイソシアネート、3, 3'-ジメトキシ-4, 4'-ビフェニルジイソシアネート、3, 3'-ジメチルジフェニルメタン-4, 4'-ジイソシアネート、キシリレン-1, 4-ジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルプロパンジイソシアネート、トリメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、プロピレン-1, 2-ジイソシアネート、ブチレン-1, 2-ジイソシアネート、シクロヘキシレン-1, 2-ジイソシアネート、シクロヘキシレン-1, 4-ジイソシアネート等のジイソシアネート類、p-フェニレンジイソチオシアネート、キシリレン-1, 4-ジイソチオシアネート、エチレンジイソチオシアネート等のトリイソシアネート類、4, 4'-ジメチルジフェニルメタン-2, 2', 5, 5'-テトライソシアネート等のテトライソシアネート類、ヘキサメチレンジイソシアネートとヘキサントリオールとの付加物、2, 4-トリレンジイソシアネートとプレントツカテコールとの付加物、トリレン

ジイソシアネートとヘキサントリオールとの付加物、トリレンジイソシアネートとトリメチロールプロパンの付加物、キシリレンジイソシアネートとトリメチロールプロパンの付加物、ヘキサメチレンジイソシアネートとトリメチロールプロパンの付加物、トリフェニルジメチレントリイソシアネート、テトラフェニルトリメチレンテトライソシアネート、ペンタフェニルテトラメチレンペンタイソシアネート、リジンイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート等の脂肪族多価イソシアネートの三量体のようなイソシアネートプレポリマー等があげられる。これらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。

【0037】

や機械的強度の点から、トリレンジイソシアネートとトリメチロールプロパンの付加物、キシリレンジイソシアネートとトリメチロールプロパンの付加物、トリフェニルジメチレントリイソシアネート等のポリメチレンポリフェニルイソシアネート類に代表されるイソシアネートプレポリマーを用いることが好ましい。

【0038】

一方、上記多価イソシアネート類と反応させる多価アミン類としては、分子内に2個以上のアミノ基を有する化合物であればよく、具体的にはジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、1, 6-ヘキサメチレンジアミン、1, 8-オクタメチレンジアミン、1, 12-ドデカメチレンジアミン、o-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、o-キシリレンジアミン、m-キシリレンジアミン、p-キシリレンジアミン、メンタンジアミン、ビス(4-アミノ-3-メチルシクロヘキシル)メタン、イソホロンジアミン、1, 3-ジアミノシクロヘキサン、スピロアセタール系ジアミン等があげられる。これらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。

【0039】

また、上記多価イソシアネート類と水との反応では、まず、多価イソシアネート類の加水分解によってアミンが形成され、このアミンが未反応のイソシアネート基と反応(いわゆる自己重付加反応)することによって、前記一般式(1)で

表される構造単位を有する重合体を主成分とする重合体が形成される。

【0040】

さらに、上記シェル部（壁膜）を形成する重合体として、例えば、上記多価イソシアネートとともに多価アルコールを併用して、ウレタン結合を併有したポリウレタン-ポリウレアをあげることができる。

【0041】

上記多価アルコールとしては、脂肪族、芳香族または脂環族のいずれであってもよく、例えば、カテコール、レゾルシノール、1, 2-ジヒドロキシ-4-メチルベンゼン、1, 3-ジヒドロキシ-5-メチルベンゼン、3, 4-ジヒドロキシ-1-メチルベンゼン、3, 5-ジヒドロキシ-1-メチルベンゼン、2, 4-ジヒドロキシエチルベンゼン、1, 3-ナフタレンジオール、1, 5-ナフタレンジオール、2, 7-ナフタレンジオール、2, 3-ナフタレンジオール、o, o'-ビフェノール、p, p'-ビフェノール、ビスフェノールA、ビス-(2-ヒドロキシフェニル)メタン、キシリレンジオール、エチレングリコール、1, 3-プロピレングリコール、1, 4-ブチレングリコール、1, 5-ペンタンジオール、1, 6-ヘキサレンジオール、1, 7-ヘプタンジオール、1, 8-オクタンジオール、1, 1, 1-トリメチロールプロパン、ヘキサントリオール、ペンタエリスリトール、グリセリン、ソルビトール等があげられる。これらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。

【0042】

上記マイクロカプセル型硬化促進剤は、例えば、下記に示す3段階の工程を経由することにより作製することができる。

【0043】

〔第1工程〕

コア成分である硬化促進剤を、壁膜（シェル）の原料である多価イソシアネート中に溶解もしくは微分散して油相を形成する。ついで、分散安定剤を含有する水系媒体（水相）中に、上記油相を油滴状に分散させてO/W型（油相/水相型）のエマルジョンを作製する。つぎに、上記O/W型エマルジョンの水相に、多価アミンを添加して溶解することにより、油相中の多価イソシアネートとの間で

界面重合させて重付加反応を生起する。あるいは、上記 O/W 型エマルジョンを加温することによって、油相中の多価イソシアネートが水相との界面で水と反応してアミンを生成し、引き続き自己重付加反応を生起する。このようにして、ポリウレア系の重合体、好ましくは前記一般式 (1) で表される構造単位を有するポリウレアをシェル部（壁膜）とするマイクロカプセルを作製することにより、マイクロカプセル分散液が得られる。

【0044】

一方、固体状の硬化促進剤を有機溶剤に溶解してコア成分とする場合には、S/O/W（固相/油相/水相）タイプのエマルジョンとなる。また、このエマル

場合には上記エマルジョンタイプに形成され難いが、この場合には溶解度の調整を行うことにより O/O（油相/油相）型のエマルジョンタイプや、S/O/O（固相/油相/油相）型のエマルジョンタイプとして界面重合を行えばよい。

【0045】

この場合の有機溶剤としては、室温で液状であれば特に限定するものではないが、少なくともシェル部（壁膜）を溶解しないものを選択する必要がある。具体的には、酢酸エチル、メチルエチルケトン、アセトン、塩化メチレン、キシレン、トルエン、テトラヒドロフラン等の有機溶剤のほか、フェニルキシリルエタン、ジアルキルナフタレン等のオイル類を用いることができる。

【0046】

〔第 2 工程〕

上記第 1 工程で得られたマイクロカプセル分散液に対して、ブロック化剤を添加し溶解もしくは分散させる。このとき、遠心分離等により一度水相中の分散安定剤や未反応アミンを取り除いた後に、上記ブロック化剤を添加することが効果的である。

【0047】

〔第 3 工程〕

上記第 2 工程でアミノ基をブロック化剤でブロックしたマイクロカプセル分散液を、遠心分離や濾過等により、過剰のブロック化剤を取り除いた後、乾燥する

ことにより、粉末状のマイクロカプセル型硬化促進剤を作製することができる。

【0048】

まず、上記第1工程において、水系媒体（水相）に添加する分散安定剤としては、ポリビニルアルコール、ヒドロキシメチルセルロース等の水溶性高分子類、アニオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤等の界面活性剤類等があげられる。また、コロイダルシリカ、粘度鉱物等の親水性無機コロイド物質類等を使用することもできる。これら分散安定剤の添加量は、水相中、0.1～10重量%となるよう設定することが好ましい。

【0049】

また、上記第2工程において使用するブロック化剤としては、アミノ基と反応性を有する化合物であれば特に限定するものではないが、例えば、エポキシ化合物、アルデヒド化合物、酸無水物、エステル化合物、イソシアネート化合物等のアミノ基と反応し共有結合を形成する化合物があげられる。さらに、酢酸、蟻酸、乳酸、蔞酸、琥珀酸等の有機カルボン酸類、p-トルエンスルホン酸、2-ナフタレンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸等の有機スルホン酸類、フェノール化合物、ホウ酸、リン酸、硝酸、亜硝酸、塩酸等の無機酸類、シリカ、アエロジル等の酸性表面を有する固体物質等のアミノ基と中和反応し塩を形成する酸性化合物があげられる。そして、これら化合物のなかでも、上記酸性化合物は壁膜表面および壁膜内部に存在するアミノ基を効果的にブロックする化合物として好ましく用いられ、特に蟻酸、有機スルホン酸類が好ましく用いられる。

【0050】

上記ブロック化剤の添加量は、壁膜表面および壁膜内部に存在するアミノ基と等量モル数のブロック化剤が添加される。実用的には、例えば、ブロック化剤として酸性化合物を用いる場合、マイクロカプセル調製（界面重合）直後の分散液に酸性物質（酸性化合物）を添加し、分散液のpHを塩基性から酸性、好ましくはpH2～5に調整し、しかる後、遠心分離や濾過等の手段により過剰の酸性化合物を除去する方法があげられる。

【0051】

また、上記第1～第3工程からなるマイクロカプセル型硬化促進剤の製法にお

いて、第2工程として、マイクロカプセル分散液を酸性陽イオン交換樹脂カラムを通すことにより、未反応の遊離アミンを除去したり、残存アミノ基を中和させる手法も用いられる。

【0052】

得られたマイクロカプセル型硬化促進剤の平均粒径は、特に限定されるものではないが、例えば、均一な分散性の観点から、 $0.05 \sim 500 \mu\text{m}$ の範囲に設定することが好ましく、より好ましくは $0.1 \sim 30 \mu\text{m}$ である。上記マイクロカプセル型硬化促進剤の形状としては球状が好ましいが楕円状であってもよい。そして、このマイクロカプセルの形状が真球状ではなく楕円状や扁平状等のよう

粒径とする。

【0053】

さらに、上記マイクロカプセル型硬化促進剤において、内包される硬化促進剤の量は、マイクロカプセル全量の $10 \sim 95$ 重量%に設定することが好ましく、特に好ましくは $30 \sim 80$ 重量%である。すなわち、硬化促進剤の内包量が 10 重量%未満では、硬化反応の時間が長くなりすぎて反応性に乏しくなり、逆に硬化促進剤の内包量が 95 重量%を超えると、壁膜の厚みが薄すぎてコア部（硬化剤）の隔離性や機械的強度に乏しくなる恐れがあるからである。

【0054】

また、上記マイクロカプセル型硬化促進剤の粒径に対するシェル部（壁膜）の厚みの比率は $3 \sim 25\%$ に設定することが好ましく、特に好ましくは $5 \sim 25\%$ に設定される。すなわち、上記比率が 3% 未満ではエポキシ樹脂組成物製造時の混練工程において加わる剪断力（シア）に対して十分な機械的強度が得られず、また、 25% を超えると内包される硬化促進剤の放出が不十分となる傾向がみられるからである。

【0055】

そして、上記潜在性硬化促進剤（C成分）の配合量は、前記固形フェノール樹脂（B成分） 100 重量部（以下「部」と略す）に対して $0.1 \sim 40$ 部に設定することが好ましい。特に好ましくは $5 \sim 20$ 部である。すなわち、上記潜在性

硬化促進剤の配合量が、0.1部未満では、硬化速度が遅すぎて強度の低下を引き起こし、40部を超えると、硬化速度が速過ぎて流動性が損なわれるおそれがあるからである。

【0056】

なお、本発明において、C成分である潜在性硬化促進剤として、上記した硬化促進剤含有マイクロカプセル以外に、所期の目的を損なわなければ、市販のマイクロカプセル型硬化促進剤を用いることができる。市販品としては、例えば商品名MCE-9957（日本化薬社製、メチルメタアクリレートを壁膜として使用しているもの）、旭チバ社製のノバキュアー（商品名HX-3748, 3741, 3742, HX-3921HR, HX-3941HP）等があげられる。また、マイクロカプセル型硬化促進剤以外の硬化促進剤であってもジシアンジアミド、または、富士化成工業社製のフジキュアーFXR-1030、FXE-1000等の触媒活性が弱いものや、通常の硬化促進剤を少量添加し触媒活性を弱くしたものでよい。

【0057】

上記A～C成分とともに用いられる無機質充填剤（D成分）としては、特に限定するものではなく各種の無機質充填剤を用いることができる。例えば、シリカ、クレー、石膏、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化アルミナ、酸化ベリリウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素、アエロジル等があげられるが、ニッケル、金、銅、銀、錫、鉛、Bi等の導電性粒子を加えてもよい。なかでも、球状シリカ粉末、具体的には、球状溶融シリカ粉末が特に好ましく用いられる。さらに、平均粒径0.01～60 μ mの範囲のものが好ましく、より好ましくは0.1～15 μ mの範囲のものである。なお、本発明において、球状とは、フロー式粒子像分析装置（SYSMEX社製のFPIA-100型）を用いて測定される真球度が平均で0.85以上であることをいう。

【0058】

そして、上記無機質充填剤（D成分）の含有割合は、半導体封止用樹脂組成物全体中の15～85重量%となるように設定することが好ましく、特に好ましくは50～80重量%である。すなわち、無機質充填剤の含有割合が15重量%未

満では、25℃での粘度が低くなり、貯蔵時に無機質充填剤の沈降が生じたり、吸湿率が高くなって耐湿信頼性が悪くなる傾向がみられ、85重量%を超えると、流動性が低下し、吐出および塗布作業性が悪くなる傾向がみられるからである。

【0059】

さらに、本発明の半導体封止用樹脂組成物には、上記A～D成分以外に、必要に応じて他の添加剤を適宜配合することができる。

【0060】

上記他の添加剤としては、例えば難燃剤、ワックス、レベリング剤、消泡剤、

等があげられる。上記シランカップリング剤としては、例えば、 γ -メルカプトプロピルトリメトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、 β -(3,4-エポキシシクロヘキシルエチルトリメトキシシラン)、 γ -メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、アミノ基含有シラン等があげられ、これらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。

【0061】

また、上記難燃剤としては、ノボラック型ブロム化エポキシ樹脂、ブロム化ビスフェノールA型エポキシ樹脂、三酸化アンチモン、五酸化アンチモン、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム等の金属化合物、赤リン、リン酸エステル等のリン系化合物等があげられ、これらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。

【0062】

上記ワックスとしては、高級脂肪酸、高級脂肪酸エステル、高級脂肪酸カルシウム等の化合物があげられ、単独でもしくは2種以上併せて用いられる。

【0063】

さらに、本発明の半導体封止用樹脂組成物には、上記他の添加剤以外に、シリコーンオイルおよびシリコーンゴム、合成ゴム、反応性希釈剤等の成分を配合して低応力化を図ったり、耐湿信頼性テストにおける信頼性向上を目的としてハイドロタルサイト類、水酸化ビスマス等のイオントラップ剤を配合してもよい。

【0064】

本発明の半導体封止用樹脂組成物は、例えば、つぎのようにして製造することができる。すなわち、上記A～D成分ならびに必要な応じて他の添加剤を混合した後、万能攪拌釜等の混練機にかけ加熱状態で混練りして熔融混合する。つぎに、これを室温（25℃程度）にて冷却することにより目的とする半導体封止用樹脂組成物を製造することができる。なお、半導体封止用樹脂組成物の流動性を調整するため、有機溶剤を添加することもできる。上記有機溶剤としては、例えば、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン（MEK）、アセトン、ジアセトンアルコール等があげられる。これらは単独でもしくは2種以上併せて用いられる。

【0065】

このようにして得られた半導体封止用樹脂組成物は、その粘度が25℃で7000 poise以上で、かつ80℃で5000 poise以下に設定されていなければならない。特に好ましくは、25℃で7000 poise以上で、かつ80℃で3000 poise以下である。すなわち、25℃で7000 poise未満であり、かつ80℃で5000 poiseを超える場合、貯蔵安定性や吐出および塗布作業性が悪くなり、初期の特性を満足させることができないからである。

【0066】

なお、上記半導体封止用樹脂組成物の25℃および80℃における各粘度は、上記各温度においてE型粘度計を用いて測定される。具体的には、以下に示すとおりである。

【0067】

〔25℃における粘度〕

東機産業社製RE80U形でロータは3°×R7.7を用い、コーンロータ回転数1rpmで1分間前処理後、0.1rpmで10分間放置後の値を測定する。

【0068】

〔80℃における粘度〕

東機産業社製 RE80R 形で、粘度 1000 poise 未満になるものはロータ 3° × R14、粘度 1000 poise 以上になるものはロータ 3° × R7、7 を用い、コーンロータ回転数 1 rpm で 1 分間前処理後、0.5 rpm で 10 分間放置後の値を測定する。

【0069】

本発明の半導体封止用樹脂組成物を用いての半導体装置の製造は、従来公知の各種の方法により行うことができる。例えば、フリップチップ、COB、グラフトップ、キャビティーフィル等による実装においては、加温（40～90℃程度、好適には 60～80℃程度）された上記半導体封止用樹脂組成物をディスペン

により半導体装置を製造することができる。また、予め加温せずに、固形または半固形の半導体封止用樹脂組成物を半導体素子上等に対して直接貼りつけまたは塗布を行ない、その後加熱し硬化させて封止樹脂層を形成することにより半導体装置を製造することもできる。なお、上記実装は、真空下で行ってもよい。

【0070】

上記半導体装置の製造方法のうちのフリップチップ実装について、サイドフィル封止方法と、プレスバンプ封止方法と、印刷封止方法を例として具体的に説明する。

【0071】

〔サイドフィル封止方法〕

まず、配線回路基板上に複数の接続用電極部を介して半導体素子が搭載されたものを準備する。そして、予め加温（40～130℃程度、好適には 60～100℃程度）された配線回路基板と半導体素子との空隙に、加温（40～90℃程度、好適には 60～80℃程度）された上記半導体封止用樹脂組成物をディスペンサーを用いて注入し充填した後、加熱し硬化させて封止樹脂層を形成することにより、フリップチップ実装による半導体装置を製造することができる。

【0072】

なお、予め加温せずに、固形または半固形の半導体封止用樹脂組成物を半導体素子上あるいはその近傍に対して直接貼りつけまたは塗布を行ない、その後加熱

し硬化させて上記半導体素子と配線回路基板との空隙に封止樹脂層を形成することも可能である。

【0073】

また、上記サイドフィル封止方法による半導体装置の製造は、真空下で行ってもよい。真空下で行う装置としては、例えば武蔵エンジニアリング社製の型式MBC-Vシリーズ等があげられる。さらに、上記真空下で半導体装置を製造する際、真空下で配線回路基板と半導体素子との空隙に半導体封止用樹脂組成物をディスペンサーを用いて注入し充填した後、大気圧に戻してさらに半導体封止用樹脂組成物を充填するという差圧充填を行ってもよい。

【0074】

〔プレスバンプ封止方法〕

まず、配線回路基板上に加温（40～90℃程度、好適には60～80℃程度）された上記半導体封止用樹脂組成物をディスペンサーを用いてポッティングする。その後、フリップチップボンダー等によるプレスバンプ接続方式により、半導体素子と配線回路基板との電氣的接続と同時に封止樹脂層を形成することにより、フリップチップ実装による半導体装置を製造することができる。

【0075】

なお、予め加温せずに、固形または半固形の半導体封止用樹脂組成物を半導体素子あるいは配線回路基板に対して直接貼りつけまたは塗布を行い、その後プレスバンプ接続方式により、半導体素子と配線回路基板との電氣的接続と同時に封止樹脂層を形成することも可能である。

【0076】

また、上記プレスバンプ封止方法による半導体装置の製造は、必要に応じて真空下で行ってもよい。

【0077】

また、ディスペンサーを用いてポッティングする代わりに、可能であれば、印刷により塗布し、その後、フリップチップボンダー等によるプレスバンプ接続方式により、半導体素子と配線回路基板との電氣的接続と同時に封止樹脂層を形成してもよい。なお、印刷による塗布は印刷雰囲気全体を加温したり、マスク、ス

キージ等を部分的に加温してもよい（加温の目安は 4 0 ~ 1 0 0 ℃である）。

【 0 0 7 8 】

〔印刷封止方法〕

まず、配線回路基板上に複数の接続用電極部を介して半導体素子が搭載されたものを準備する。そして、予め加温（4 0 ~ 1 3 0 ℃程度、好適には 6 0 ~ 1 0 0 ℃程度）された配線回路基板と半導体素子との空隙に、加温（4 0 ~ 9 0 ℃程度、好適には 6 0 ~ 8 0 ℃程度）された上記半導体封止用樹脂組成物をディスペンサーを用いて滴下し、印刷封止にて封止樹脂層を形成することにより、フリップチップ実装による半導体装置を製造することができる。

上記印刷封止については、真空差圧を利用した東レエンジニアリング社製の真空印刷封止装置（型式 V P E - 1 0 0 シリーズ）を用いるのが、封止樹脂層に気泡が入りにくいという点で好ましい。

【 0 0 8 0 】

なお、予め加温せずに、固形または半固形の半導体封止用樹脂組成物をステージ、スキージ等に対して直接貼りつけ、塗布等を行ない、印刷封止することも可能である。

【 0 0 8 1 】

一方、上記半導体装置の製造方法のうちのキャビティーフィル形態の半導体装置の製造方法について、具体的に説明する。

【 0 0 8 2 】

まず、配線回路基板上に半導体素子が搭載され、両者がボンディングワイヤー等で電氣的に接続されたものを準備する。そして、予め加温（4 0 ~ 1 3 0 ℃程度、好適には 6 0 ~ 1 0 0 ℃程度）された配線回路基板と半導体素子に、加温（4 0 ~ 9 0 ℃程度、好適には 6 0 ~ 8 0 ℃程度）された上記半導体封止用樹脂組成物をディスペンサーを用いてポッティングし加熱硬化して半導体素子を内蔵するよう封止樹脂層を形成することにより、キャビティーフィル形態の半導体装置を製造することができる。

【 0 0 8 3 】

なお、予め加温せずに、固形または半固形の半導体封止用樹脂組成物を、直接貼りつけ、または塗布を行い、その後加熱し硬化させて上記半導体素子を内蔵するよう封止樹脂層を形成することも可能である。

【0084】

また、上記封止方法による半導体装置の製造は、真空下で行ってもよい。真空下で行う装置としては、例えば武蔵エンジニアリング社製の型式MBC-Vシリーズ等があげられる。

【0085】

他の製造方法について述べる。すなわち、まず、配線回路基板上に半導体素子が搭載され、両者がボンディングワイヤー等で電氣的に接続されたものを準備する。そして、予め加温（40～130℃程度、好適には60～100℃程度）された配線回路基板と半導体素子上に、加温（40～90℃程度、好適には60～80℃程度）された上記半導体封止用樹脂組成物を印刷等により供給し、加熱硬化して半導体素子を内蔵するよう封止樹脂層を形成することにより、キャビティーフイル形態の半導体装置を製造することができる。

【0086】

上記印刷封止による半導体装置の製造は、真空下で行ってもよい。さらに、真空下で半導体装置を製造する際、真空下で印刷封止した後、雰囲気気圧を上げて半導体封止用樹脂組成物中のボイド抜きを行い、その状態のままでさらに仕上げ印刷を行ってもよい。

【0087】

このようにして得られた半導体装置は、例えば、実装用基板（マザーボード）の搭載に用いられ半導体製品の製造に供される。すなわち、実装用基板（マザーボード）上に、複数の接続用電極部を介して、それ自体の配線回路基板を対面させた状態で半導体装置を搭載するとともに、上記実装用基板と半導体装置との間の空隙を、本発明の半導体封止用樹脂組成物を用いて充填し、加熱硬化させることにより封止樹脂層を形成して半導体製品を製造する。

【0088】

上記半導体封止用樹脂組成物を加熱硬化させる方法としては、特に限定するも

のではないが、例えば、対流式乾燥機、IRリフロー炉、ホットプレート等を用いた加熱方法等があげられる。

【0089】

また、本発明の半導体封止用樹脂組成物を用いることによる上記実装用基板と半導体装置との間の空隙の充填方法としては、例えば、先の半導体装置の製造方法のうちのフリップチップ実装について述べたのと同様の方法、サイドフィル封止方法、プレスバンプ封止方法、印刷封止方法等があげられる。なお、上記の半導体封止用樹脂組成物に、ニッケル、金、銀、銅等の導電性ペーストを分散させ、ACF (Anisotropic Conductive Film)、ACP (Anisotropic Conductive

上記半導体封止用樹脂組成物を配線回路基板上にダム材として、またダイボンダ剤や放熱板と配線回路基板との接着剤として用いてもよい。

【0090】

つぎに、実施例について比較例と併せて説明する。

【0091】

まず、実施例に先立って下記に示す各成分を準備した。

【0092】

〔エポキシ樹脂 a 1〕

ビスフェノール F 型エポキシ樹脂 (25℃で液状:エポキシ当量 158 g/ep、東都化成社製のエポトート YDF-8170)。

【0093】

〔エポキシ樹脂 a 2〕

ビスフェノール A 型エポキシ樹脂 (25℃で液状:エポキシ当量 170 g/ep、ダウケミカル社製の DER-332)。

【0094】

〔エポキシ樹脂 a 3〕

脂環式エポキシ樹脂 (25℃で液状:エポキシ当量 135 g/ep、ダイセル化学社製のセロキサイド 2021P)。

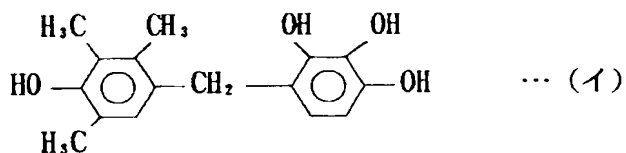
【0095】

〔フェノール樹脂 b 1〕

下記の化学式 (イ) で表される四官能固形フェノール樹脂 (25℃で固形: 融点 187℃、純度 94%、本州化学工業社製の THD-2344)。

【0096】

〔化 8〕



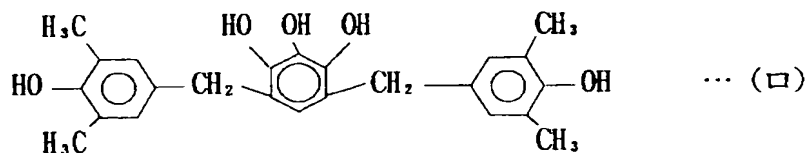
【0097】

〔フェノール樹脂 b 2〕

下記の化学式 (ロ) で表される五官能固形フェノール樹脂 (25℃で固形: 融点 182℃、純度 97.5%、本州化学工業社製の BisPG-26X)。

【0098】

〔化 9〕



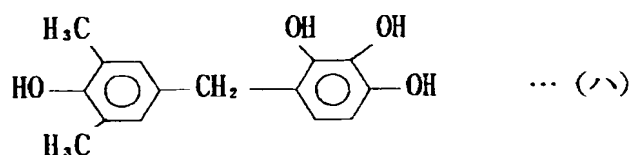
【0099】

〔フェノール樹脂 b 3〕

下記の化学式 (ハ) で表される四官能固形フェノール樹脂 (25℃で固形: 融点 156℃、純度 93.6%、本州化学工業社製の MHD-2344)。

【0100】

【化 10】



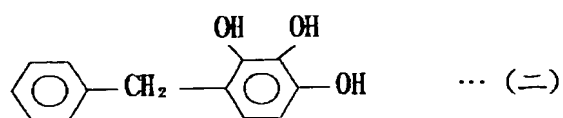
【0101】

〔フェノール樹脂 b4〕

下記の化学式(二)で表される三官能固形フェノール樹脂(25℃で固形：融

【0102】

【化 11】



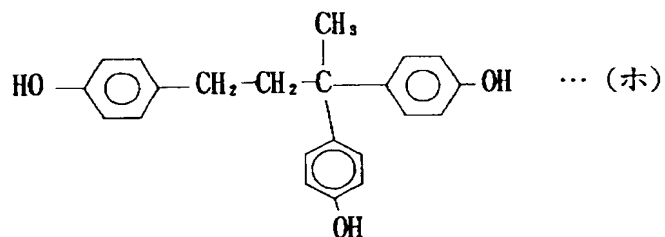
【0103】

〔フェノール樹脂 b5〕

下記の化学式(ホ)で表される固形フェノール樹脂(25℃で固形：融点95℃、純度89%、本州化学工業社製のTrisP-RK)。

【0104】

【化 12】



【0105】

〔フェノール樹脂 b 6〕

トリフェニルメタン型フェノール樹脂〔25℃で固形：水酸基当量 101 g/e p、融点 110℃、150℃粘度 3~4 p o i s e、明和化成社製の MEH-7500 (3, 4 P)〕。

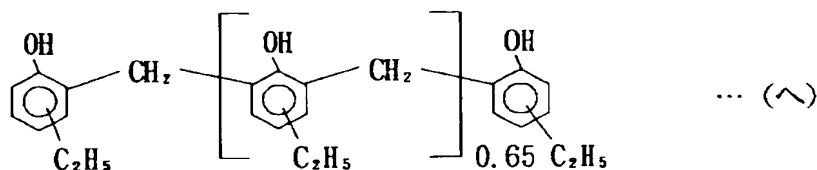
【0106】

〔フェノール樹脂 b 7〕

下記の化学式 (へ) で表される p-エチルフェノール樹脂 (25℃で固形：水酸基当量 129 g/e p、融点 98℃、明和化成社製)。

【0107】

【化 13】



【0108】

〔フェノール樹脂 b 8〕

アリル化フェノールノボラック (25℃で液状：水酸基当量 135 g/e p、昭和化成社製の MEH-8005 H)。

【0109】

〔酸無水物系硬化剤〕

メチルヘキサヒドロ無水フタル酸 (メチル化 HHPA、新日本理化社製の リカシッド MH-700)。

【0110】

〔硬化促進剤 c 1〕

前述した方法に準じてマイクロカプセル型硬化促進剤を作製した。すなわち、まず、キシリレンジイソシアネート 3 モルとトリメチロールプロパン 1 モルとの付加物 11 部、トリレンジイソシアネート 3 モルとトリメチロールプロパン 1 モ

ルとの付加物 4.6 部を、硬化促進剤としてのトリフェニルホスフィン 7 部と酢酸エチル 3.9 部との混合液中に均一に溶解させて油相を調製した。また、蒸留水 100 部とポリビニルアルコール 5 部からなる水相を別途調製し、このなかに上記調製した油相を添加してホモミキサーにて乳化しエマルジョン状態にし、これを還流管、攪拌機、滴下ロートを備えた重合反応器に仕込んだ。

【0111】

一方、トリエチレンテトラミン 3 部を含む水溶液 10 部を調製し、これを上記重合反応器に備えた滴下ルート内に入れ、反応器中のエマルジョンに滴下して 70℃で 3 時間界面重合を行い、マイクロカプセル型硬化促進剤の水性サスペン

ジオンを得た。その後、蒸留水 100 部を加え再び分散を行いサスペンションを得た。

【0112】

このサスペンションに対し、蟻酸を滴下し系の pH を 3 に調整した。これにより壁膜表面および内部のアミノ基が蟻酸によりブロックされたマイクロカプセル型硬化促進剤を作製した。このようにして得られたマイクロカプセル型硬化促進剤は遠心分離にて分別、水洗を繰り返した後、乾燥することによって自由流動性を有する粉末状粒子として単離した。このマイクロカプセル型硬化促進剤の平均粒径は 2 μm であった。また、マイクロカプセルの粒径に対するシェル厚み比率は 15% であり、トリフェニルホスフィンの内包量は全体の 30 重量% であった。

【0113】

〔硬化促進剤 c2〕

日本化薬社製の MCE-9957。

【0114】

〔硬化促進剤 c3〕

2-エチル-4-メチルイミダゾール（四国化成工業社製のキュアゾール 2E 4MZ）。

【0115】

〔無機質充填剤 d1〕

球状熔融シリカ粉末（平均粒径 $5.0 \mu\text{m}$ 、東燃化学社製の SP-4B）。

【0116】

〔無機質充填剤 d2〕

球状熔融シリカ粉末（平均粒径 $15 \mu\text{m}$ 、電気化学工業社製の FB-48X）

【0117】

〔無機質充填剤 d3〕

球状熔融シリカ粉末（平均粒径 $0.56 \mu\text{m}$ 、アドマテックス社製の SE-2100）

【0118】

〔実施例 1～12、比較例 1～4、従来例〕

上記各成分を後記の表 1～表 3 に示す配合割合で配合し、万能攪拌釜にて混練りして熔融混合した。つぎに、これを室温にて冷却することにより目的とする半導体封止用樹脂組成物を作製した。なお、混練り条件については、つぎに示すとおりである。

【0119】

〔実施例 1～8、比較例 4〕

まず、エポキシ樹脂、フェノール樹脂を仕込み、 150°C で 2 分間混合し、固形分を全て溶解した。つぎに、 $90\sim 100^{\circ}\text{C}$ まで温度を下げ、無機質充填剤を加えて 10 分間混合した。そして、 75°C の温度に調節した後、硬化促進剤を加え 2 分間混合し受け入れた。

【0120】

〔実施例 9～12、比較例 2、3〕

まず、エポキシ樹脂、フェノール樹脂を仕込み、 110°C で 5 分間混合し、固形分を全て溶解した。つぎに、 $90\sim 100^{\circ}\text{C}$ まで温度を下げ、無機質充填剤を加えて 10 分間混合した。そして、 65°C の温度に調節した後、硬化促進剤を加え 2 分間混合し受け入れた。

【0121】

〔比較例 1、従来例〕

まず、エポキシ樹脂、フェノール樹脂または酸無水物を仕込み、80℃で10分間混合した。その後、同温度で無機質充填剤を加えて10分間混合した。そして、50℃まで温度を下げ、硬化促進剤を加え2分間混合し受け入れた。

【0122】

【表1】

(部)

		実 施 例					
		1	2	3	4	5	6
エポキシ樹脂	a 1	—	—	—	—	—	—
	a 2	—	—	—	—	—	—
	a 3	—	—	—	—	—	—
フェノール樹脂	b 1	93.9	93.9	—	—	—	—
	b 2	93.9	93.9	77	80.7	93	46.5
	b 3	—	—	77	80.7	93	46.5
	b 4	—	—	—	—	—	—
	b 5	—	—	—	—	—	—
	b 6	—	—	—	—	—	—
	b 7	—	—	—	—	—	—
	b 8	—	—	—	—	—	—
酸無水物系硬化剤		—	—	—	—	—	—
硬化促進剤	c 1	21.8	—	18.0	18.7	21.6	10.9
	c 2	—	32.9	—	—	—	—
	c 3	—	—	—	—	—	—
無機質充填剤	d 1	140	140	1005	962	900	190
	d 2	746	746	—	—	—	1010
全体中の無機質充填剤の含有割合(重量%)		59	59	66	64	59	79

【0123】

【表 2】

(部)

		実 施 例					
		7	8	9	1 0	1 1	1 2
エポキシ樹脂	a 1	311	825	—	366	—	285
	a 2	—	—	420	—	—	—
	a 3	—	—	—	—	300	—
フェノール樹脂	b 1	—	—	—	—	—	—
	b 2	69. 8	186	—	—	—	—
	b 3	69. 8	186	—	—	—	—
	b 4	—	—	173	—	—	—
	b 5	—	—	—	—	—	301
	b 6	—	—	—	234	—	—
	b 7	—	—	—	—	287	—
	b 8	—	—	—	—	—	—
酸無水物系硬化剤		—	—	—	—	—	—
硬化促進剤	c 1	16. 4	43. 5	20. 0	27. 4	33. 5	35. 2
	c 2	—	—	—	—	—	—
	c 3	—	—	—	—	—	—
無機質充填剤	d 1	167	47. 3	140	900	139	139
	d 2	884	253	747	—	741	740
全体中の無機質充填剤の含有割合(重量%)		69	19	59	59	59	59

【0 1 2 4】

【表 3】

(部)

		比 較 例				従 来 例
		1	2	3	4	
エポキシ樹脂	a 1	239	206	—	186	290
	a 2	—	213	420	—	—
	a 3	—	—	—	—	—
フェノール樹脂	b 1	—	—	—	—	—

	b 3	—	—	—	41.9	—
	b 4	—	181	173	—	—
	b 5	—	—	—	—	—
	b 6	—	—	—	—	—
	b 7	—	—	—	—	—
	b 8	204	—	—	—	—
酸無水物系硬化剤		—	—	—	—	308
硬化促進剤	c 1	23.8	21.2	—	9.8	—
	c 2	—	—	—	—	—
	c 3	—	—	3.5	—	6.1
無機質充填剤	d 1	164	142	140	195	142
	d 2	869	757	747	1035	754
全体中の無機質充填剤の含有割合(重量%)		69	59	60	81	60

【0 1 2 5】

このようにして得られた実施例および比較例の半導体封止用樹脂組成物について、25℃および80℃における各粘度をE型粘度計を用い前述の方法に従って測定した。さらに、ガラス転移温度(T_g)、貯蔵安定性(無機質充填剤の沈降度合い、粘度変化の度合い)、吐出および塗布作業性、可使時間について、下記

の方法に従って測定・評価した。また、上記半導体封止用樹脂組成物を用いて作製した半導体装置の耐湿信頼性を下記の方法に従って測定・評価した。そして、これらの結果を後記の表 4 ～ 表 7 に示した。

【0 1 2 6】

〔ガラス転移温度 (T_g)〕

予め脱泡処理した半導体封止用樹脂組成物を 1 5 0℃で 3 時間硬化させたテストピースを、リガク社製の TMA 装置 (型番 MG 8 0 0 GM) を用い測定した。なお、測定条件は、昇温 5℃/min で荷重 3 0 g で行った。そして、横軸を温度、縦軸を伸びとするグラフ図を作成し、5 0 ～ 7 0℃間の接線と 2 0 0 ～ 2 3 0℃間の接線との交点を T_g として求めた。

【0 1 2 7】

〔貯蔵安定性〕

* 1 : 無機質充填剤の沈降度合い

内径 1 6 mm φ、高さ 1 8 0 mm の試験管に半導体封止用樹脂組成物を入れて密栓し (試料高さ : 1 2 0 mm)、2 5℃で 3 0 日間放置後、無機質充填剤の沈降度合いを確認した。沈降有無の判断としては、無機質充填剤が沈降するとその部分の半導体封止用樹脂組成物の濁度レベルが変わるため、目視にて濁度変化を確認した。濁度が減少 (透明度が増す) したものを沈降有りとした。沈降部分の高さが 1 mm 以上のものを沈降有りとして × を表示し、沈降部分が全くないものを沈降無しとして ⊙ を表示した。

* 2 : 粘度変化の度合い

2 5℃の雰囲気中に放置し (3 0 日)、放置前後の粘度を E 型粘度計を用いて測定した (測定温度 : 8 0℃、従来例については測定温度 : 2 5℃)。そして、放置後の粘度が放置前の粘度の 1. 5 倍以下のものに ⊙、放置後の粘度が放置前の粘度の 1. 5 倍を超え 3. 0 倍以下のものに ○、放置後の粘度が放置前の粘度の 3. 0 倍を超え 1 0 倍以下のものに △、放置後の粘度が放置前の粘度の 1 0 倍を超えるものに × をつけた。なお、E 型粘度計を用いての粘度の測定は、前記 2 5℃または 8 0℃における粘度の測定方法と同様にして行った。

【0 1 2 8】

〔吐出性、塗布作業性〕

80℃に加温した半導体封止用樹脂組成物をディスペンサーを用いて時間と圧力の一定条件で吐出した時の吐出量で評価した。すなわち、武蔵エンジニアリング社製のシリンジ10cc、金属ニードルSN-17G（内径2.4mm）を用い、圧力5kg/cm²で10秒後の吐出量を測定した。その結果、吐出量が1000mg以上のものを◎、200mg以上1000mg未満のものを○、50mg以上200mg未満のものを△、50mg未満のものを×とした。なお、上記条件で50mg未満であれば、半導体の樹脂封止が不可のレベルである。

【0129】

各半導体封止用樹脂組成物について、50℃×72時間放置前後の粘度をE型粘度計を用いて測定した（測定温度：80℃、従来例については測定温度：25℃）。そして、放置後の粘度が放置前の粘度の1.5倍以下のものに◎、放置後の粘度が放置前の粘度の1.5倍を超え3.0倍以下のものに○、放置後の粘度が放置前の粘度の3.0倍を超え10倍以下のものに△、放置後の粘度が放置前の粘度の10倍を超えるものに×をつけた。なお、E型粘度計を用いての粘度の測定は、前記25℃または80℃における粘度の測定方法と同様に行った。

【0130】

〔耐湿信頼性〕

上記各半導体封止用樹脂組成物を用いてつぎのようにして半導体装置を製造した。すなわち、まず、半導体チップを実装したデュアルインラインパッケージ（DIP）フレームをDIP金型にセットし、金型を140℃に加温した（従来例については110℃）。そして、予め脱泡処理を行ない、60～120℃に加熱した熔融状の半導体封止用樹脂組成物を滴下し、150℃で3時間の条件で硬化し（従来例については110℃で20時間の条件で硬化）、半導体装置を作製した。そして、耐湿下、130℃×85%RH×2.3atm（印加バイアス30V）に投入し、各パターンの導通チェックを行ない、不導通になれば不良品とする。なお、導通チェックは室温に取り出した後に行った。パッケージの不良率〔（不良パターン数／全パターン数）×100〕が50%以上になった時間を確認し

た。なお、その他の条件は、以下のとおりである。

- ・評価パッケージ : DIP16
- ・リードフレーム : 4.2アロイ, 厚み 0.25 mm
- ・チップ : シンコー社製の全面 A1 モデル素子 3×6 mm
(A1 パターン厚み $5 \mu\text{m}$, 幅 $5 \mu\text{m}$)
- ・ワイヤー : 99.99% Gold SR $25 \mu\text{m} \phi$
- ・Agペースト : 日立化成社製の EN-4000
- ・評価 n 数 : 10 パッケージ/試料 (1 パッケージに、+極 2 パターン、
-極 2 パターンが配線されているので計 40 パターン測定できる。)
- ・PCT 条件 : $130^\circ\text{C} \times 85\% \text{RH} \times 2.3 \text{ atm}$
(印加バイアス 30 V)

【0131】

【表 4】

		実 施 例			
		1	2	3	4
2 5℃での性状		半固形	半固形	半固形	半固形
粘度(poise)	25℃	105000	104000	30万超	30万超
	80℃	25	24	4600	2500
ガラス転移温度(℃)		137	136	134	134
	* 1	◎	◎	◎	◎
吐出性、塗布作業性		◎	◎	○	◎
可使時間		◎	○	◎	◎
耐湿信頼性(PCT)		200<	200<	200<	200<

* 1 : 無機質充填剤の沈降度合い

* 2 : 粘度変化の度合い

【 0 1 3 2 】

【表 5】

		実 施 例			
		5	6	7	8
2 5℃での性状		半固形	固 形	半固形	半固形
粘度(poise)	25℃	17400	固 体	161000	13200
	80℃	1300	3070	68	16
ガラス転移温度 (℃)		135	134	135	136
貯蔵安定性	* 1	◎	◎	◎	◎
	* 2	◎	◎	◎	◎
吐出性、塗布作業性		◎	○	◎	◎
可使時間		◎	◎	◎	◎
耐湿信頼性 (P C T)		200<	200<	200<	100

* 1 : 無機質充填剤の沈降度合い

* 2 : 粘度変化の度合い

【 0 1 3 3 】

【表 6】

		実 施 例			
		9	10	11	12
2 5℃での性状		半固形	固 形	半固形	固 形
粘度(poise)	25℃	9600	固 体	11400	固 体
	80℃	10	160	25	328
ガラス転移温度 (℃)		120	129	112	107
		◎	◎	◎	◎
		* 2	◎	◎	◎
吐出性、塗布作業性		◎	◎	◎	◎
可使時間		◎	◎	○	◎
耐湿信頼性 (P C T)		180	200<	90	180

* 1 : 無機質充填剤の沈降度合い

* 2 : 粘度変化の度合い

【 0 1 3 4 】

【表 7】

		比 較 例				従 来 例
		1	2	3	4	
25℃での性状		液 状	液 状	半固形	固 形	液 状
粘度(poise)	25℃	5700	6500	11000	固 体	850
	80℃	15	33	15	5600	15
ガラス転移温度 (℃)		59	126	130	133	140
貯蔵安定性	* 1	×	×	◎	◎	×
	* 2	◎	◎	×	◎	×
吐出性、塗布作業性		◎	◎	◎	×	◎
可使時間		◎	◎	×	◎	△
耐湿信頼性 (P C T)		70	190	60	190	20

* 1 : 無機質充填剤の沈降度合い

* 2 : 粘度変化の度合い

【0 1 3 5】

上記表 4 ～ 表 7 の結果から、全ての実施例品は、従来例品に比べ、無機質充填剤の沈降がなく、また可使時間が長く、貯蔵安定性に優れていることがわかる。そして、吐出および塗布作業性にも優れており、得られる半導体装置の耐湿信頼性も良好であることがわかる。特に、実施例 1 品～ 9 品は、固形フェノール樹脂として多官能固形フェノール樹脂を用いているため、多官能固形フェノール樹脂ではない固形フェノール樹脂を用いたものに比べ、ガラス転移温度が高くなっている。また、実施例 1 品、3 品～ 12 品は、潜在性硬化促進剤として特定のマイクロカプセル型硬化促進剤を用いているため、市販のマイクロカプセル型硬化促進剤を用いたものに比べ、可使時間が非常に長く、貯蔵安定性に特に優れている。

【0 1 3 6】

これに対し、比較例 1 品は、液状エポキシ樹脂と液状フェノール樹脂を用いているため、貯蔵安定性が悪くなり、無機質充填剤の沈降が生じていることがわかる。また、比較例 2 品も、25℃の粘度で 7000 poise 未満であるため、無機質充填剤の沈降が生じていることがわかる。さらに、比較例 3 品は、潜在性硬化促進剤ではない硬化促進剤を用いているため、可使時間が短くなり、貯蔵時の粘度変化が大きくなっていることがわかる。そして、比較例 4 品は、半導体封止用樹脂組成物の粘度が 80℃で 5000 poise を超えているため、吐出および塗布作業性が悪くなっていることがわかる。

【0137】

【0138】

【実施例 13】

前記実施例 4 で作製した半導体封止用樹脂組成物を予め 70℃の真空下で減圧脱泡したものを用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、予め 100℃に加温された配線回路基板上に 70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物をディスペンサーを用いてポッティングした。その後、フリップチップボンダーを用い、上記配線回路基板上に半導体素子を搭載し、熱圧着接続（条件：150℃×2kg×30分+220℃×0.5kg×2分）により半導体素子と配線回路基板とを接続用電極部により電氣的に接続すると同時に配線回路基板と半導体素子との空隙に封止樹脂層を形成することによりフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0139】

【実施例 14】

前記実施例 5 で作製した半導体封止用樹脂組成物を予め 70℃の真空下で減圧脱泡したものを用いた。それ以外は上記実施例 13 と同様にしてフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0140】

【実施例 15】

前記実施例 9 で作製した半導体封止用樹脂組成物を予め 70℃の真空下で減圧

脱泡したものを、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、配線回路基板上に半導体素子が搭載され、両者がボンディングワイヤーで電氣的に接続されたものを準備した。そして、予め70℃に加温された配線回路基板と半導体素子上に、70℃に加温された上記半導体封止用樹脂組成物を5 Torrの真空下でマスクの開口部を通じて印刷により塗布した。つぎに、雰囲気圧を150 Torrに設定し、上記半導体封止用樹脂組成物中のボイド抜きを行い、その150 Torrの状態を維持したまま上記70℃に加温された上記半導体封止用樹脂組成物を用いて仕上げ印刷を行った。その後、150℃×3時間の条件で加熱硬化して半導体素子を内蔵するよう封止樹脂層を形成することにより、キャピティーフイル形態の半導体装置を製造した。

【0141】

【実施例16】

前記実施例10で作製した半導体封止用樹脂組成物を予め70℃の真空下で減圧脱泡したものを、それ以外は上記実施例13と同様にしてフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0142】

〔半導体封止用樹脂組成物 α の作製〕

前記各成分を下記の表8に示す配合割合で配合し、万能攪拌釜にて混練りして溶融混合した後、70℃で真空脱泡した。つぎに、これを室温にて冷却することにより目的とする半導体封止用樹脂組成物を作製した。なお、混練り条件については、つぎに示すとおりである。すなわち、まず、エポキシ樹脂、フェノール樹脂を仕込み、150℃で2分間混合し、固形分を全て溶解した。つぎに、90～100℃まで温度を下げ、無機質充填剤を加えて10分間混合した。そして、75℃の温度に調節した後、硬化促進剤を加え2分間混合し受け入れた。

【0143】

得られた半導体封止用樹脂組成物 α について、25℃および80℃における各粘度をE型粘度計を用い前述の方法に従って測定した。さらに、ガラス転移温度(T_g)、貯蔵安定性(無機質充填剤の沈降度合い、粘度変化の度合い)、吐出および塗布作業性、可使時間について、前記と同様の方法に従って測定・評価し

た。また、上記半導体封止用樹脂組成物 α を用いて作製した半導体装置の耐湿信頼性を前記と同様の方法に従って測定・評価した。そして、これらの結果を下記の表 8 に併せて示した。

【 0 1 4 4 】

【表 8】

(部)

		半導体封止用 樹脂組成物 α
エポキシ樹脂	a 1	4 1 4
フェノール樹脂	b 2	9 3
	b 3	9 3
硬化促進剤	c 1	2 1. 6
無機質充填剤	d 3	9 0 0
全体中の無機質充填剤の含有割合(重量%)		5 9
2 5 °Cでの性状		半固形
粘度(poise)	25°C	5 1 0 0 0
	80°C	1 7
ガラス転移温度(°C)		1 3 3
貯蔵安定性	* 1	◎
	* 2	◎
吐出および塗布作業性		◎
可使時間		◎
耐湿信頼性(PCT)		2 0 0 <

* 1 : 無機質充填剤の沈降度合い

* 2 : 粘度変化の度合い

【 0 1 4 5 】

【実施例 17】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、配線回路基板上に接続用電極部を介して半導体素子が搭載されたものを準備した。そして、予め100℃に加温された配線回路基板および半導体素子との空隙に、70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α をディスペンサーを用いて充填した。その後、150℃×3時間で加熱硬化させて配線回路基板と半導体素子との空隙に封止樹脂層を形成することによりフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0146】

【実施例 18】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、配線回路基板上に接続用電極部を介して半導体素子が搭載されたものを準備した。そして、予め70℃に加温された配線回路基板および半導体素子との空隙に、5 Torrの真空下で70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α をディスペンサーを用いて充填した。その後、150℃×3時間で加熱硬化させて配線回路基板と半導体素子との空隙に封止樹脂層を形成することによりフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0147】

【実施例 19】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、配線回路基板上に接続用電極部を介して半導体素子が搭載されたものを準備した。そして、予め70℃に加温された配線回路基板および半導体素子との空隙に、5 Torrの真空下で70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α をディスペンサーを用いて充填した。その後、さらに大気圧に戻し、上記70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α を充填（差圧充填）した後、150℃×3時間で加熱硬化させて配線回路基板と半導体素子との空隙に封止樹脂層を形成することによりフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0148】

【実施例 20】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、予め100℃に加温された配線回路基板上に70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α をディスペンサーを用いてポッティングした。その後、フリップチップボンダーを用い、上記配線回路基板上に半導体素子を搭載し、熱圧着接続（条件：150℃×2kg×30分+220℃×0.5kg×2分）により半導体素子と配線回路基板とを接続用電極部により電氣的に接続すると同時に配線回路基板と半導体素子との空隙に封止樹脂層を形成することによりフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0149】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、予め100℃に加温された半導体素子上に70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α をディスペンサーを用いてポッティングした。その後、フリップチップボンダーを用い、上記半導体素子上に70℃に加温された配線回路基板を搭載し、熱圧着接続（条件：150℃×2kg×30分+220℃×0.5kg×2分）により半導体素子と配線回路基板とを接続用電極部により電氣的に接続すると同時に配線回路基板と半導体素子との空隙に封止樹脂層を形成することによりフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0150】

【実施例22】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、予め70℃に加温された配線回路基板上に70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α を、5 Torrの真空下でディスペンサーを用いてポッティングした。その後、フリップチップボンダーを用い、上記配線回路基板上に半導体素子を搭載し、熱圧着接続（条件：150℃×2kg×30分+220℃×0.5kg×2分）により半導体素子と配線回路基板とを接続用電極部により電氣的に接続すると同時に配線回路基板と半導体素子との空隙に封止樹脂層を形成することによりフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0151】

【実施例 2 3】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、予め70℃に加温された半導体素子上に70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α を、5 Torrの真空下でディスペンサーを用いてポッティングした。その後、フリップチップボンダーを用い、上記半導体素子上に70℃に加温された配線回路基板を搭載し、熱圧着接続（条件：150℃×2 kg×30分+220℃×0.5 kg×2分）により半導体素子と配線回路基板とを接続用電極部により電氣的に接続すると同時に配線回路基板と半導体素子との空隙に封止樹脂層を形成することによりフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0 1 5 2】

【実施例 2 4】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、予め70℃に加温された半導体素子上に70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α をマスクの開口部を通じて印刷により塗布した。その後、フリップチップボンダーを用い、上記半導体素子上に70℃に加温された配線回路基板を搭載し、熱圧着接続（条件：150℃×2 kg×30分+220℃×0.5 kg×2分）により半導体素子と配線回路基板とを接続用電極部により電氣的に接続すると同時に配線回路基板と半導体素子との空隙に封止樹脂層を形成することによりフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0 1 5 3】

【実施例 2 5】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、予め70℃に加温された配線回路基板上に70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α をマスクの開口部を通じて印刷により塗布した。その後、フリップチップボンダーを用い、上記配線回路基板上に半導体素子を搭載し、熱圧着接続（条件：150℃×2 kg×30分+220℃×0.5 kg×2分）により半導体素子と配線回路基板とを接続用電極部により電氣的に接続すると同時に配線回路基板と半導体素子との空隙に封止樹脂層を形成することによりフリ

ップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0154】

【実施例 26】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、予め 70℃ に加温された半導体素子上に 70℃ に加温された半導体封止用樹脂組成物 α を、5 Torr の真空下でマスクの開口部を通じて印刷により塗布した。その後、フリップチップボンダーを用い、上記半導体素子上に 70℃ に加温された配線回路基板を搭載し、熱圧着接続（条件：150℃ × 2 kg × 30 分 + 220℃ × 0.5 kg × 2 分）により半導体素子と配線回路基板とを

隙に封止樹脂層を形成することによりフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0155】

【実施例 27】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、予め 70℃ に加温された配線回路基板上に 70℃ に加温された半導体封止用樹脂組成物 α を、5 Torr の真空下でマスクの開口部を通じて印刷により塗布した。その後、フリップチップボンダーを用い、上記配線回路基板上に半導体素子を搭載し、熱圧着接続（条件：150℃ × 2 kg × 30 分 + 220℃ × 0.5 kg × 2 分）により半導体素子と配線回路基板とを接続用電極部により電氣的に接続すると同時に配線回路基板と半導体素子との空隙に封止樹脂層を形成することによりフリップチップ実装による半導体装置を製造した。

【0156】

【実施例 28】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、配線回路基板上に半導体素子が搭載され、両者がボンディングワイヤーで電氣的に接続されたものを準備した。そして、予め 100℃ に加温された半導体素子上に、70℃ に加温された半導体封止用樹脂組成物 α をディスペンサーを用いてポッティングした。その後、150℃ × 3 時間で加熱硬化させて半

導体素子を内蔵するよう封止樹脂層を形成することによりキャビティーフィル形態の半導体装置を製造した。

【0157】

【実施例 29】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、配線回路基板上に半導体素子が搭載され、両者がボンディングワイヤーで電氣的に接続されたものを準備した。そして、予め70℃に加温された半導体素子上に、70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α を、5 Torrの真空下でディスペンサーを用いてポッティングした。その後、150℃×3時間で加熱硬化させて半導体素子を内蔵するよう封止樹脂層を形成することによりキャビティーフィル形態の半導体装置を製造した。

【0158】

【実施例 30】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、配線回路基板上に半導体素子が搭載され、両者がボンディングワイヤーで電氣的に接続されたものを準備した。そして、予め70℃に加温された半導体素子上に、70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α をマスクの開口部を通じて印刷により塗布した。その後、150℃×3時間で加熱硬化させて半導体素子を内蔵するよう封止樹脂層を形成することによりキャビティーフィル形態の半導体装置を製造した。

【0159】

【実施例 31】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、配線回路基板上に半導体素子が搭載され、両者がボンディングワイヤーで電氣的に接続されたものを準備した。そして、予め70℃に加温された半導体素子上に、70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α を、5 Torrの真空下でマスクの開口部を通じて印刷により塗布した。その後、150℃×3時間で加熱硬化させて半導体素子を内蔵するよう封止樹脂層を形成することによりキャビティーフィル形態の半導体装置を製造した。

【0 1 6 0】

【実施例 3 2】

上記半導体封止用樹脂組成物 α を用い、つぎのようにして半導体装置を作製した。すなわち、配線回路基板上に半導体素子が搭載され、両者がボンディングワイヤーで電氣的に接続されたものを準備した。そして、予め70℃に加温された半導体素子上に、70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α を、5 Torrの真空下でマスクの開口部を通じて印刷により塗布した。つぎに、雰囲気圧を150 Torrに設定し、上記半導体封止用樹脂組成物 α 中のボイド抜きを行い、その150 Torrの状態を維持したまま70℃に加温された上記半導体封止用

化させて半導体素子を内蔵するよう封止樹脂層を形成することによりキャビティーフイル形態の半導体装置を製造した。

【0 1 6 1】

【実施例 3 3】

実装用基板（マザーボード）上に、上記実施例 2 0 で作製した半導体装置を載置し、電氣的に接続して100℃に加温したものを準備した。その後、70℃に加温された半導体封止用樹脂組成物 α を、実装用基板と半導体装置との間の空隙にディスペンサーを用いて充填した。そして、150℃×3時間で硬化することにより半導体装置と実装用基板との空隙に封止樹脂層を形成して半導体製品を製造した。

【0 1 6 2】

上記のようにして得られた各半導体装置および実装用基板上に半導体装置が搭載された装置の封止樹脂層について、気泡の有無を目視により確認した。その結果を下記の表 9 ～ 表 1 1 に示す。

【0 1 6 3】

【表 9】

	実 施 例								
	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1
気泡の有無	少量 有り	少量 有り	少量 有り	少量 有り	少量 有り	無し	無し	少量 有り	少量 有り

【0 1 6 4】

【表 1 0】

	実 施 例								
	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0
気泡の有無	無し	無し	少量 有り	少量 有り	無し	無し	有り	少量 有り	有り

【0 1 6 5】

【表 1 1】

	実 施 例		
	3 1	3 2	3 3
気泡の有無	少量 有り	無し	少量 有り

【0 1 6 6】

上記表 9 ～ 表 1 1 の結果から、実施例 2 8、3 0 を除き殆どの半導体装置の封止樹脂層には気泡が無い、あるいは少量の気泡が確認される程度であった。

【0 1 6 7】

【発明の効果】

以上のように、本発明は、液状エポキシ樹脂（A成分）と、固形フェノール樹脂（B成分）と、潜在性硬化促進剤（C成分）と、無機質充填剤（D成分）とを含有する半導体封止用樹脂組成物であって、25℃および80℃の各温度における、半導体封止用樹脂組成物の粘度が特定の範囲に設定されている。このため、従来の液状封止剤に比べ可使時間が長くなり、貯蔵安定性に優れている。しかも、室温で固形または半固形であっても、40～80℃程度の低い温度で急激に粘度が低下して液状化できるため、吐出および塗布作業性に優れている。また、本発明の半導体封止用樹脂組成物は、室温下において、固形または半固形の状態で貯蔵できるため、無機質充填剤（D成分）が沈降してしまうことがない。したが

状化して用いることができるため、良好な封止を行うことができ、結果、信頼性、特に耐湿信頼性の高い半導体装置が得られる。

【0168】

特に、上記固形フェノール樹脂（B成分）のなかでも多官能固形フェノール樹脂を用いた場合には、ガラス転移温度（T_g）が高くなり、耐熱性が高くなるという利点がある。

【0169】

そして、上記潜在性硬化促進剤（C成分）として、特定のシェル部で硬化促進剤からなるコア部が被覆されたコア／シェル構造を有するマイクロカプセル型硬化促進剤を用いた場合には、それを含有してなる半導体封止用樹脂組成物は、可使時間が非常に長くなり、貯蔵安定性に特に優れるという利点がある。

【0170】

さらに、上記無機質充填剤（D成分）として球状溶融シリカを用い、これが半導体封止用樹脂組成物全体中に特定の割合で含有されている場合には、それを含有してなる半導体封止用樹脂組成物は、流動性に優れるようになり、吐出および塗布作業性に特に優れるという利点がある。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】耐湿信頼性および貯蔵安定性に優れるとともに、吐出および塗布作業性にも優れた半導体封止用樹脂組成物を提供する。

【解決手段】下記の（Ａ）～（Ｄ）成分を含有する半導体封止用樹脂組成物であって、上記半導体封止用樹脂組成物の粘度を 25℃で 7000 p o i s e 以上で、かつ 80℃で 5000 p o i s e 以下に設定するようにした。

（Ａ）液状エポキシ樹脂。

（Ｂ）固形フェノール樹脂。

（Ｃ）潜在性硬化促進剤。

（Ｄ）無機質充填剤。

【選択図】なし

特平 11-212068

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003964]

1. 変更年月日	1990年 8月31日
[変更理由]	新規登録
住 所	大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
氏 名	日東電工株式会社